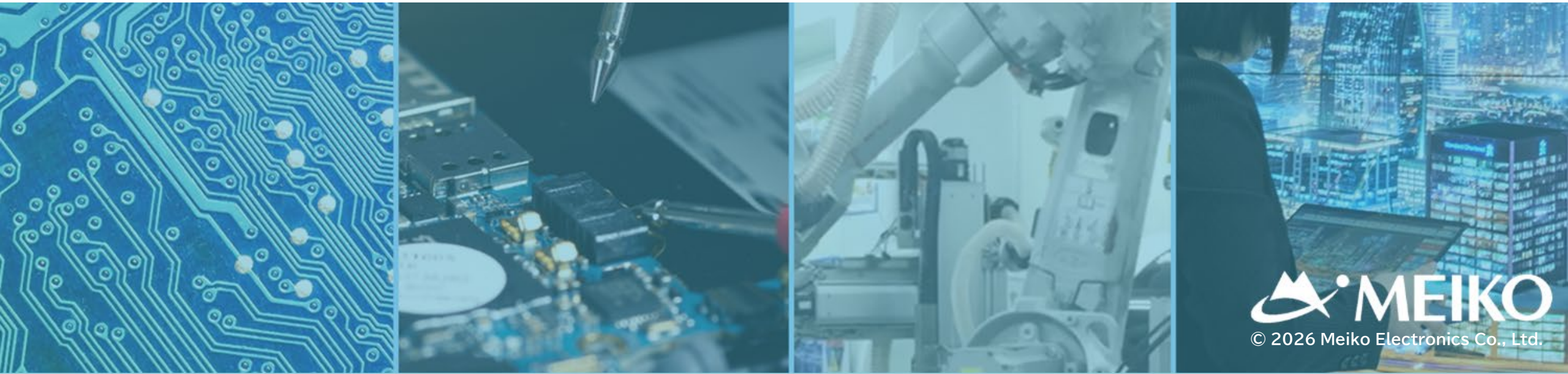
2026年度上期

決算補足説明資料

2026年11月6日



© 2026 Meiko Electronics Co., Ltd.

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

事業の概況

●決算の概要

	上期実績			通期予想		
売上	1,658億円	前年同期比 +543億円	48.7% 増加	3,800億円	前年比 +1,394億円	58.0% 増加
営業利益	175億円	前年同期比 +61億円	53.2% 増加	480億円	前年比　+234 億円	95.3% 増加

●電子回路基板事業

・衛星通信をはじめ各商品分野で、売上・利益ともに拡大基調で推移。
・原材料の供給不足により調達コストが大幅に増加。販売価格を改定。

商品別説明

・車載	日系車載需要の回復に加え、米国・中国ＥＶ売上が増加基調で推移
・衛星通信	米国衛星通信向けユーザーターミナル（地上受信機器）売上が大幅に増加
・スマートフォン	ホアビン工場において米国スマートフォン顧客向け生産を開始
・半導体PKG/モジュール	SSD関連の売上が好調に推移
・ＡＩサーバー	８月より生産を開始
・光トランシーバー	下期後半より生産を開始

E-SSDはAIサーバーからモジュール基板に変更しています

➡本年５月に公表した2026年度業績予想を見直すこととした。

2025年度上期実績と2026年度上期実績、下期・通期予想

（単位：億円）

		2025年度		2026年度							
		上期実績	利益率	上期実績	利益率	増減	増減率	下期予想	利益率	通期予想	利益率
売上高	基板	920		1,354		434	47.2%	1,846		3,200	
	電子機器	195		304		109	55.9%	296		600	
		1,115		1,658		543	48.7%	2,142		3,800	
営業利益	基板	100	10.9%	159	11.7%	59	59.0%	281	15.2%	440	13.8%
	電子機器	14	7.2%	16	5.3%	2	14.3%	24	8.1%	40	6.7%
		114	10.2%	175	10.6%	61	53.2%	305	14.2%	480	12.6%
経常利益		114	10.2%	143	8.6%	29	25.6%	307	14.3%	450	11.8%
当期純利益		94	8.4%	110	6.6%	16	16.7%	230	10.7%	340	8.9%
期中平均為替ﾚｰﾄ（JPY/USD）		146.04		160.04				150.00		155.19	

商品別売上高　2025年度上期実績、2026年度上期実績、下期予想

（単位：億円）

	2025年度		2026年度						
	上期実績	通期実績	上期実績	増減額	増減率	下期予想	通期予想	増減額	増減率
車載	469	975	589	120	25.6%	711	1,300	325	33.3%
スマートフォン	132	294	162	30	22.7%	178	340	46	15.6%
衛星通信	109	282	335	226	207.3%	535	870	588	208.5%
半導体PKG、モジュール	85	185	144	59	69.4%	141	285	100	54.1%
アミューズメント、産業機器、その他	125	244	120	-5	-4.0%	125	245	1	0.4%
AIサーバー	0	0	4	4	-	136	140	140	-
光トランシーバー	0	0	0	0	-	20	20	20	-
基板	**920**	**1,980**	**1,354**	**434**	**47.2%**	**1,846**	**3,200**	**1,220**	**61.6%**
EMS	87	197	118	31	35.6%	57	175	-22	-11.2%
ODM	108	229	186	78	72.2%	239	425	196	85.6%
電子機器	**195**	**426**	**304**	**109**	**55.9%**	**296**	**600**	**174**	**40.8%**
合計	**1,115**	**2,406**	**1,658**	**543**	**48.7%**	**2,142**	**3,800**	**1,394**	**58.0%**

仕様別売上高　2025年度上期実績、2026年度上期実績、下期予想

（単位：億円）

	2025年度		2026年度						
	上期実績	通期実績	上期実績	増減額	増減率	下期予想	通期予想	増減額	増減率
多層貫通基板	386	820	508	122	31.6%	532	1,040	220	26.8%
ビルドアップ基板	497	1,098	806	309	62.2%	1,084	1,890	792	72.1%
高多層ビルド(20層以上)	0	0	4	4	-	136	140	140	-
微細ビルド(MSAP)	0	0	2	2	-	38	40	40	-
パッケージ基板(FCBGA/CAP)	11	20	10	-1	-9.1%	30	40	20	100.0%
フレキシブル基板	19	32	20	1	5.3%	20	40	8	25.0%
放熱基板	7	10	4	-3	-42.9%	6	10	0	0.0%
電子回路基板	**920**	**1,980**	**1,354**	**434**	**47.2%**	**1,846**	**3,200**	**1,220**	**61.6%**
EMS	87	197	118	31	35.6%	57	175	-22	-11.2%
ODM	108	229	186	78	72.2%	239	425	196	85.6%
電子機器	**195**	**426**	**304**	**109**	**55.9%**	**296**	**600**	**174**	**40.8%**
合計	**1,115**	**2,406**	**1,658**	**543**	**48.7%**	**2,142**	**3,800**	**1,394**	**58.0%**

中期経営計画修正の概要

（単位：億円）

2025年度と中計最終年度（2028年度）の比較

	2025年度		2028年度		増加率	年平均成長率
売上	2,406億円		6,600億円		2.7倍	40.0%
営業利益	246億円	営業利益率 10.2%	1,000億円	営業利益率 15.2%	4倍	59.6%

商品別の売上見通し

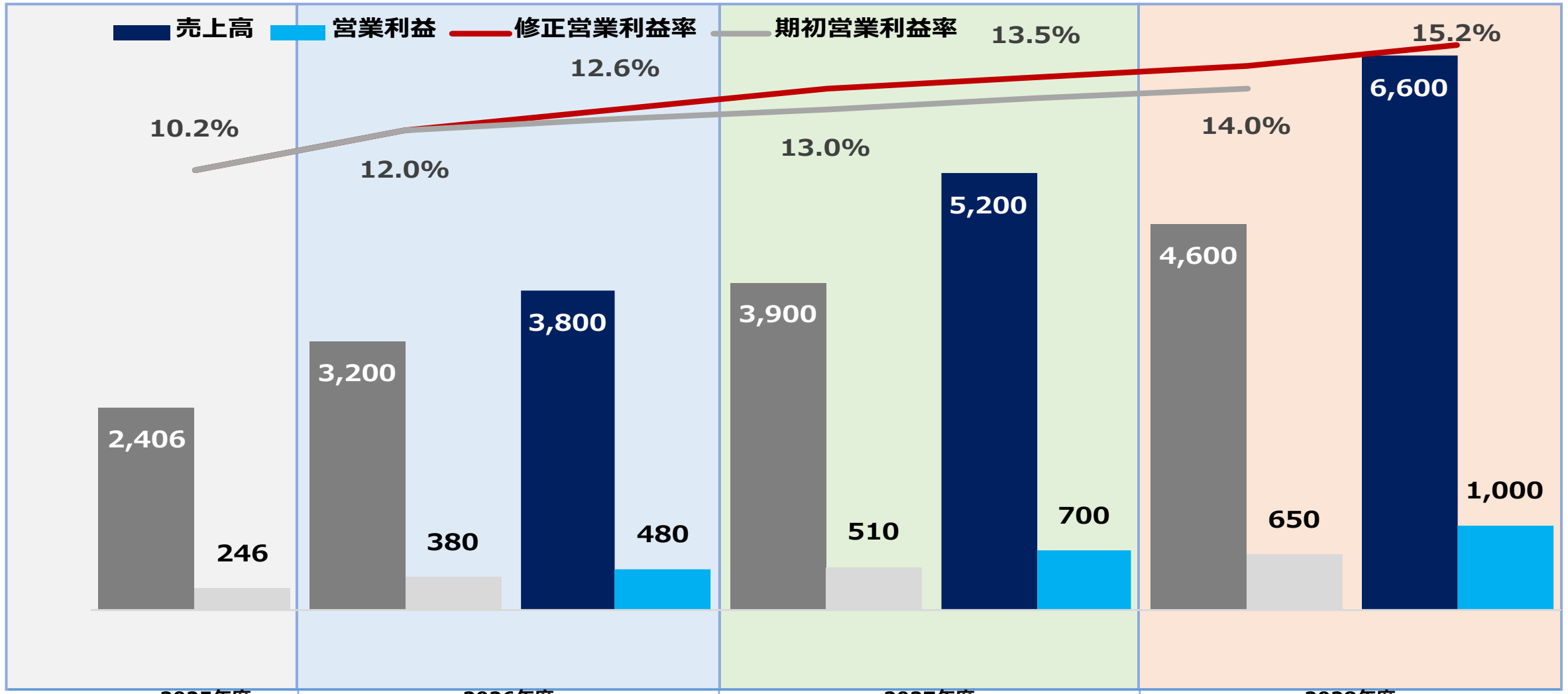
・衛星通信、AIサーバー、光トランシーバー、スマートフォン、半導体PKG/モジュールは大幅に増加
・車載、アミューズメント/産業機器/他は緩やかに増加

生産キャパの拡大

・ベトナム第４工場、ホアビン工場は今年度末から本格生産を開始
・イエンクアン工場、クアンミン工場は2028年度から本格生産を開始
・今期投資を250億円追加

中期経営計画の見直し

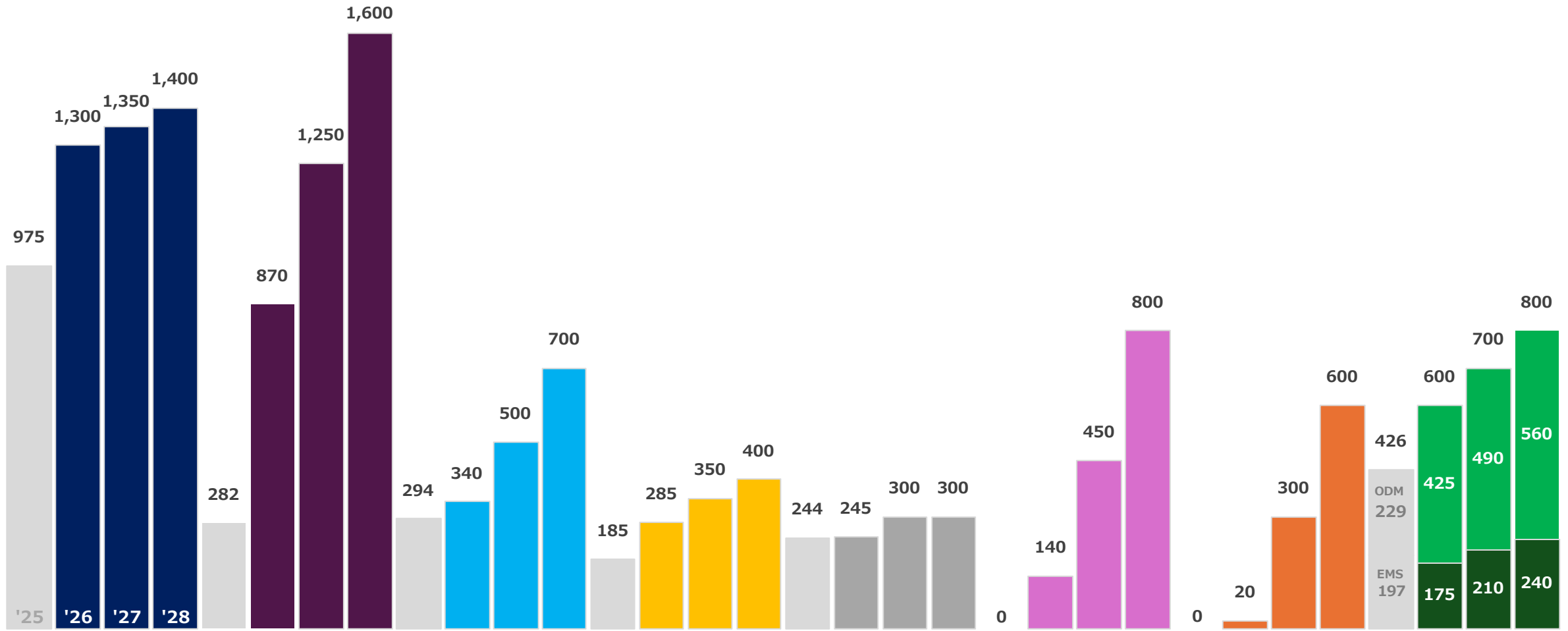
（単位：億円）



	2025年度	2026年度		2027年度		2028年度	
	実績	期初予想	修正予想	期初予想	修正予想	期初予想	修正予想
設備投資額	497	700	950	700	700	700	700

中期経営計画　商品別売上高（2025～2028年度）

（単位：億円）

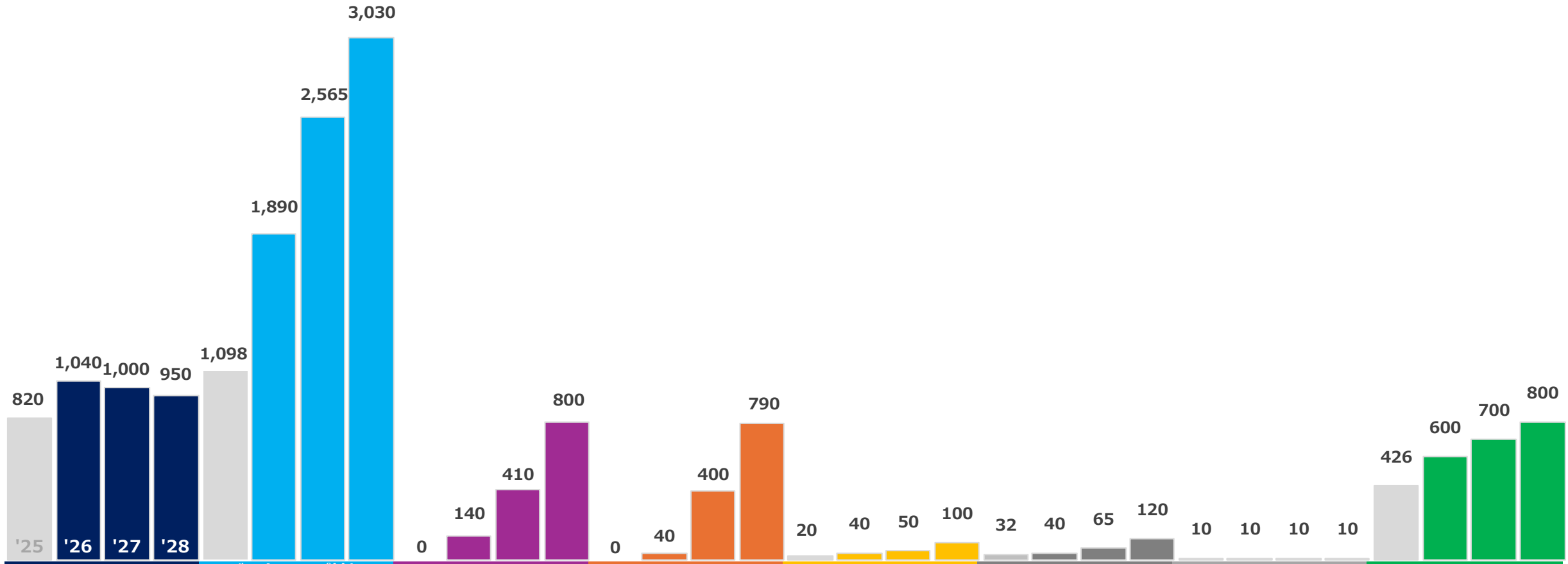


構成比	40.5%	34.2%	26.0%	21.2%	11.7%	22.9%	24.0%	24.2%	12.2%	8.9%	9.6%	10.6%	7.7%	7.5%	6.7%	6.1%	10.1%	6.4%	5.8%	4.5%	0.0%	3.7%	8.7%	12.1%	0.0%	0.5%	5.8%	9.1%	17.7%	15.8%	13.5%	12.1%

E-SSDは半導体PKG/モジュールに含めた

中期経営計画　仕様別売上高（2025～2028年度）

（単位：億円）



構成比	34.1%	27.4%	19.2%	14.4%	45.6%	49.7%	49.3%	45.9%	3.7%	7.9%	12.1%	1.1%	7.7%	12.0%	0.8%	1.1%	1.0%	1.5%	1.3%	1.1%	1.3%	1.8%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%	17.7%	15.8%	13.5%	12.1%

財務指標と株主還元 実績と予想

（単位：億円）

	2023年度（実績）	2024年度（実績）	2025年度（実績）	2026年度（予想）	2027年度（予想）	2028年度（予想）
売上高合計	1,795	2,068	2,406	3,800	5,200	6,600
営業利益	117	191	246	480	700	1,000
営業利益率（%）	6.5	9.2	10.2	12.6	13.5	15.2
経常利益	143	188	265	450	650	920
当期純利益	113	149	198	340	490	690
投資額	199	298	497	950	700	700
研究開発費	53	63	60	114	156	198
EBITDA	228	316	368	662	1,060	1,421
総資産合計	2,300	2,564	3,353	4,719	5,639	6,590
純資産合計	1,055	1,156	1,438	1,623	1,961	2,571
有利子負債残高	793	868	1,219	2,067	2,336	2,364
自己資本比率（%）	42.7	42.2	40.7	32.9	33.5	38
D/Eレシオ	0.75	0.75	1.15	1.3	1.2	0.8
ROE（%）	10.7	12.9	14.6	19.7	25.1	27.9
ROIC（%）	6.1	9.0	7.7	11.6	13.4	16.4
DOE（%）	2.0	2.2	2.5	2.8	3.8	4.2
1株当たり純利益（円）	428.7	569.5	758.6	1,253	1,822	2,575
(分割後)	214.4	284.8	379.3	626.5	911.0	1287.5

為替レート：150円 (JPY/USD)